

新聞稿

ASMPT 勇奪 2015 香港工商業獎科技成就大獎

ASMPT 新研發的熱壓式覆晶焊接設備憑藉非凡的創新獲獎



ASMPT 香港研發中心 TCB 科技團隊開發的熱壓式覆晶焊接設備榮獲 2015 香港工商業獎科技成就大獎

香港和新加坡, 2015 年 12 月 15 日 – ASM Pacific Technology (下簡稱為「ASMPT」/「集團」) (股份代號: 0522) 為全球領先的半導體裝配及包裝設備、材料及表面貼裝技術供貨商今天宣布, 該集團的熱壓式覆晶焊接設備榮獲 2015 香港工商業獎科技成就大獎。

由香港特別行政區政府全力支持的香港工商業獎, 旨在嘉許香港企業在邁向高科技、高增值的過程中取得的成就, 以及在不同範疇的傑出表現。香港工商業獎有助提升香港工商業的競爭力及推廣香港品牌。由香港科技园公司(科技园公司)主辦的「香港工商業獎: 科技成就」是香港工商業獎七個獎項組別之一, 是香港科技企業最崇高的獎項之一, 其目的為表揚卓越的科技及知識產權的開發, 以及其對香港的貢獻; 加強工商業界對採用及發展科技的認識; 以及提高香港工商業的競爭力。

ASMPT 與世界主要的半導體公司合作研發了一台突破性的熱壓焊接機用以覆晶焊接 (TCB) 半導體晶片。該覆晶焊接設備能夠個別優化應用於中央處理器及高頻寬記憶體的微距銅柱之焊接, 並活用 ASMPT 專利的自動控制技術, 把晶片底下愈來愈緊密的線路, 精準地焊接於線路板或其他晶片上, 令集成電路尺寸更細, 計算效能更高, 以滿足現代社會對晶片需求的急劇增長。這項研發對半導體行業, 以至數據中心、伺服器及高端電腦等行業有重要影響, 讓相關行業的主要產品推陳出新, 也為未來智慧型電子產品微型化作出貢獻。

ASMPT 集團行政總裁李偉光表示：「能夠獲得這一久負盛名的獎項，我們深感榮幸。這一獎項充分顯出 ASMPT 對創新的不斷追求與承諾，是對集團的香港科研團隊過去多年努力工作的認可。該獎也說明了香港不但是個國際金融中心，亦擁有一班頂尖的科研人才，可以開發出一流技術的先進產品。ASMPT 將繼續維持研發投資，並務求不斷改進自身業務，為香港以及各地提供更多元化的產品。」

ASMPT 非常注重產品與技術研究，每年研發投入高達其全年設備業務營業額的 10 %。該集團於全球聘請超過一千七百名專業的工程師和科學家組成科研團隊，其中六百名以香港為基地。在過去的四十年，ASMPT 不斷投放資源於研發方面，使它得以保持強勁的競爭優勢。至今，ASMPT 穩佔半導體裝嵌及封裝設備和表面貼裝技術方案市場領導地位。

該獲獎的熱壓式覆晶焊接設備是由 ASMPT 香港研發中心 TCB 科技團隊開發的。ASMPT 的熱壓焊接機符合並超越熱壓焊接技術的成功準則，例如在處理翹板、晶片傾斜、晶片間隙控制、焊點成品、工藝一致、取放晶片時之焊位精度及焊接品質監察等方面均表現出色。該熱壓焊接機的主要競爭優勢包括：高精度的 X-Y-Z 固晶、實時閉環控制、惰氣室、和機台一致性。此嶄新的熱壓焊接技術自 2014 年起廣泛應用在高性能中央處理器的量產。

- 完 -